

项目名称：南通康源集成电路封装基板项目(一期)-干膜垂直显影线1条

招标项目编号：0730-234012SZ0357/02

招标范围：0730-234012SZ0357/02 南通康源集成电路封装基板项目(一期)-干膜垂直显影线1条

招标机构：中航技国际经贸发展有限公司

招标人：南通康源电路科技有限公司

开标时间：2023-12-19 10:00

公示开始时间：2023-12-22 15:19

评标公示截止时间：2023-12-25 23:59

中标候选人名单：

候选人排名	投标商名称	制造商	制造商国别及地区
1	深圳市泰科思特精密工业有限公司	迈达微(深圳)半导体技术有限公司	中国
2	TAESUNG CO., LTD.	TAESUNG CO.,LTD.	韩国